

2002

	Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců	ČSN EN 60191-6-2 35 8791
---	---	--

idt IEC 60191-6-2:2001

Mechanical standardization of semiconductor devices -

Part 6-2: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages -

Design guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs -

Partie 6-2: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs pour

montage en surface - Guide de conception pour les boîtiers à broches en forme de billes et de colonnes, avec des pas de 1,50 mm, 1,27 mm et 1,00 mm

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -

Teil 6-2: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von SMD-Halbleitergehäusen -

Konstruktionsleitfaden für Gehäuse mit Kugel- und Säulenanschlüssen in einem Raster von 1,50 mm, 1,27 mm und 1,00 mm

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60191-6-2:2002 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60191-6-2:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60191-6-2 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60191-6-2:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60191-6-2:2002 Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-2: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60191-6-2:2001, was approved by the Czech Standards

Institute for direct use as the ČSN EN 60191-6-2 without any modification. The European Standard EN 60191-6-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část mezinárodní normy IEC 60191 obsahuje požadavky na přípravu výkresů různých pouzder integrovaných obvodů s kuličkovými vývody, např. keramická CBGA, plastická PBGA, na pásku TBGA a další, stejně jako pouzdra s vývody uspořádanými do sloupce, např. keramická CCGA. Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy evropské a 10 stran anglického textu normy mezinárodní.

© Český normalizační institut,
2002

65629

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

-- Vynechaný text --